

Plasma-Reinigung verbessert Drahtbond-Verbindungen



Openair-Plasma-Technologie bietet zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten im Bondbereich. Das Verfahren ist besonders effektiv für die Reinigung von Oberflächen. Metalle können schnell und selektiv gereinigt und damit für das Wire-Bonden vorbereitet werden. Bei dem von der Plasmatreat GmbH entwickelten Verfahren kann auf den Einsatz von Reinigungsmedien verzichtet werden, wodurch sich K[] 0 ,eiten im Bondbereich. Das V